

株式会社 アルバック

**2026年6月期3Q WEB決算説明会（2026年5月12日開催）****およびアナリストミーティングの主な質疑応答****【3Q決算概要・通期業績予想】****1. 3Q受注高・売上高・各利益項目の実績について教えてください。**

**A:** ロジックの成熟ノードMHM工程の集中的な投資、レアアース関連の受注が本格的に開始したことから、受注高は991億円、3Q累計では2,362億円となり、四半期および3Q累計で過去最高となった。売上高は、半導体電子が2Q比で増加するなど655億円と高水準が継続した。売上総利益率についても、半導体電子の売上高構成比が増加したことで2Q比2.9pt改善し32%となった。一方、EV関連の費用計上など一過性要因が影響し、営業利益率は9.2%と2Qからの改善は限定的となった。

**2. 事業環境は3か月前と比較してどうか？**

**A:** 特にAI関連ビジネスである、ロジック・メモリ・パッケージングの受注が引き続き増加しているほか、ディスプレイ・一般産業・マテリアルも上振れ基調となり、3か月前と比較して全体的に力強い推移に転じています。

**3. 業績予想修正について教えてください。**

**A:** 受注高予想については、前回予想比に対してプラス300億円、過去最高水準となる3,100億円に上方修正しました。また、前期受注高2,256億円から大きく積み上がった今期受注高3,100億円に対し、受注から売上計上までのタイムラグにより、売上高は前回予想比+100億円の2,600億円となる見込みですが、来期は受注好調を追い風に、売上・利益の成長を図ってまいります。

一方で、EV関連費用の計上などの一過性要因により、営業利益を190億円へ下方修正しました。また、経常利益は、営業利益の減少に伴い、190億円へ修正、当期純利益は、譲渡益による特別利益および事業改革による特別損失計上などを反映し、185億円を予想しております。

**4. 一過性要因の詳細を教えてください。3Q・4Qではどのように計上されるのか？**

**A:** 一過性費用58億円については、四半期それぞれ、3QにEV関連費用等で約23億円を主に貸倒引当金として販管費に計上し、4Qに約35億円を追加コスト計上等で売上原価に織り込んだ。

**<一過性要因>**

- ①売上期ズレ（半導体）14億円：顧客要因により、大口の検収基準案件が4Qから来期計上となった
- ②EV関連費用37億円：貸倒引当金や追加コストの計上等によるもの
- ③品質検証補完対応7億円：マテリアル事業の検査装置不具合によるリカバリー費用

## 【投資動向】

### 5. 半導体（ロジック・メモリ）の投資動向と今後の見通しについて教えてください。

#### A: ロジック

3Q ロジック受注は約 150 億円と好調で、中国大手顧客や台湾ファウンドリ向け見込んでいるため、通期計画は期初見通しから大幅増となる約 310 億円程度を予測しています。

応力制御膜技術を強みに、成熟ノードの MHM で圧倒的なシェアを確立し、デファクトスタンダード化しています。次フェーズに向けた投資計画も予定されていることから、高水準のビジネスが継続すると見込んでいます。

#### メモリ（DRAM・NAND）

DRAM は下期に北米顧客からの受注が増加し、期初計画を上回る 230 億円程度の受注を予測しています。また、NAND においても、次世代向けの投資が継続しています。メモリ全体では期初計画以上の 300 億円超の受注水準を予想しております。

これまで獲得してきた金属膜工程における POR 実績を起点に、デバイスの世代交代局面でも採用が継続したことに加え、新工場への展開でも採用が進んだことで受注が増加しています。今後は、大手メモリメーカーの工場拡張に伴う装置需要の拡大により、さらなる成長を見込んでいます。

### 5. パッケージングの投資動向は？

A: GPU 需要増加に伴うパッケージング増産によりアッシング装置の受注が好調に推移し、通期計画を 200 億円台へと引き上げました。WLP 向けアッシング装置に加え、台湾 OSAT や国内メーカー向けの PLP（パネルレベルパッケージ）投資（約 40~50 億円規模）の寄与を見込んでいます。微細プラズマ技術を強みに、デスクム工程でデファクトスタンダード化が進んでいます。生産能力増強に伴う投資が継続的に見込まれるほか、市場拡大が期待される PLP 関連ビジネスについても先行して獲得を進めてまいります。

### 6. パワーデバイス・オプトデバイスの投資動向は？

A: パワーデバイスは中国市場での需要トーンダウンにより投資時期の後ろ倒しが発生しており、受注は当初想定を下回る推移となっており、当面弱含むことが予想されます。このような事業環境の下、次世代パワーデバイスである窒化ガリウム（GaN）対応の技術展開など新素材分野での市場開拓を強化し、挽回を図ってまいります。

オプトデバイスは、期初は中国市場における AR/VR 向け大口案件を想定していましたが、収益性を重視する観点から、当社にしか対応できないスパッタリング装置などの収益性の高い案件のみを限定的に受注することにしたため、期初受注計画の 160 億円半ばから 60 億円程度までに見直しました。

### 7. ディスプレイ・エネルギーの投資動向は？

A: 中国メーカーによる G8 サイズ OLED 向けの新規ライン投資や LCD の設備追加投資案件など、計画外の受注があり、期初計画から +300 億円の 700 億円を見込んでおります。収益性においては構造的に半導体電子関連と比較すると低いものの、過去の案件と比較して採算改善が進んでいます。

なお、ディスプレイ事業に関する方針に変更無く、半導体電子へのリソースをシフトしつつ、ディスプレイ関連の生産については中国へ移管・集中することで、生産効率の最適化と利益率のさらなる改善を図ってまいります。

## 8. レアアース磁石関連ビジネス（一般産業）の投資動向は？

A: 3Q で米国中心の受注が増加するなど、サプライチェーンの多角化による生産拡大が本格化しています。一般産業は、これまで 200 億円前後の受注高水準で推移してきましたが、レアアース磁石等の強い需要を取り込むことで、今後 3～5 年のスパンでは 350～450 億円規模に定着すると期待しています。また、当該装置は既存技術をベースとした高収益な製品であり、利益面でも大きく貢献する見込みです。

### 【バリューアッププラン（事業改革・生産改革）等】

## 9. 事業改革・生産改革の進捗状況について教えてください。

### A: 事業改革

マテリアル事業（ディスプレイ関連）については、特に今期の大きな取り組みの一つであるディスプレイ関連のマテリアル事業に関して 5 月から 6 月に中核会社の持分譲渡完了を予定しております。

それにより、今期末時点の到達見込みとしては 4 社の非連結化が完了する予定であり、譲渡益は約 80 億円となる見込みです。また、人員適正化の進捗率として 4 割程度を見込んでおり、事業改革は計画通りに進捗しています。

### 生産改革

生産改革につきましても、バリューアッププラン 1 年目の成果が早期に具現化しております。

変動費につきましては約 10 億円の圧縮を達成できる見込みであり、設計工数につきましても 31 年 6 月期の最終目標である設計リードタイム 70%減に対して現時点で約 20%の削減を実現、最終目標に対し進捗率は約 3 割に達しております。

今後、生産改革の諸施策を確実に具体化させるとともに、半導体電子などのモジュラーデザイン装置の構成比拡大や製造拠点の集約を加速させます。2028 年 6 月期以降の加速度的な利益改善に向け、変動費・固定費の圧縮を一段と強力に推進まいります。

## 10 外部環境として、関税や地政学リスクの影響はありますか？

A: 基本的に関税については、買い手負担を適用しているため、関税による直接影響は限定的です。エンド需要減速による間接影響を引き続き注視していきます。また、現時点で顧客からの受注に目立った変化ありません。中東情勢による直接的な影響はございません。一方、中国からのレアアース等の円滑な調達是不透明感が高まっています。

### 【27/6 期の見通し】

## 11. 来期（27/6 期）ガイダンスの水準は？

A: 今期の受注は好調で、来期にかけて売上・利益への寄与が見込まれます。一方で、

①事業改革による売上・利益の減少分（300 億円程度売上減少の想定）

②受注の集中による生産面での調整に加え、地政学リスクに伴う部材調達難による

装置リードタイムの長期化も懸念されることから、現時点では来期の数値について引き続き精査しています。

**12 27/6 期の利益率改善の考え方は？**

- A:** 高利益率案件である半導体・レアアース関連ビジネスの受注増加により、来期の利益率改善に寄与する見込みです。加えて、事業改革による利益率改善効果も段階的に発現することから全体として利益率向上が期待されます。一方で、当初見込んでいたパワーデバイス等の高利益率案件の剥落に加え、ディスプレイ関連の計画以上の受注によるミックス悪化の影響、半導体・レアアース関連ビジネスの受注の集中による生産面での調整に加え、地政学リスクに伴う部材調達難による装置リードタイムの長期化も懸念されます。これらを踏まえると、利益率改善は段階的にならざるを得ないと考えています。

以上